

## EV Group und ITRI vertiefen Zusammenarbeit – September 1, 2022

### EV Group und ITRI vertiefen Zusammenarbeit

1. September 2022, 8:24 Uhr | [Heinz Arnold](#)



Der Hauptsitz des ITRI in Chutung, Taiwan: Hier werden auch mit Hilfe der neusten Maschinen von EVG neue Prozesse für das Advanced Packaging und die heterogene Integration entwickelt, die sich schnell in die Stückzahlfertigung transferieren lassen.

### **Die EV Group (EVG) hat die Zusammenarbeit mit dem ITRI erweitert, um neue Prozesse für Advanced Packaging, insbesondere für Chiplets zu entwickeln.**

Das Industrial Technology Research Institute (ITRI) mit Sitz in Taiwan gehört zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen für die Entwicklung anwendungsorientierter Technologien und hat sich auf Advanced Packaging und die heterogene Integration spezialisiert.

Mit Unterstützung des Department of Industrial Technology (DoIT) des Wirtschaftsministeriums von Taiwan (MOEA) hat das ITRI die »Heterogeneous Integration Chiplet System Package Alliance« (Hi-CHIP) ins Leben gerufen, um ein Ecosystem zu schaffen, das vom Package-Design über Test und Verifizierung bis zur Pilotproduktion die gesamte Lieferkette abdecken und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen kann.

Als Mitglied der Hi-CHIP Alliance hat [EVG](#) verschiedene ihrer fortschrittlichsten Wafer-Bonding- und Lithographiesysteme an das ITRI geliefert, darunter das Maskless-Exposure-Lithography-System vom Typ

»LITHOSCALE«, das automatische Debonding-System »EVG 850 DB« und das Hybrid Bonding System »GEMINI FB«. Die Installation dieser Fertigungsplattformen für die Verarbeitung hoher Stückzahlen in der modernen Fab von ITRI versetzt die Kunden beider Unternehmen in die Lage, ihre Entwicklungen zu beschleunigen und vereinfacht den Transfer neuer heterogener Integrationsprozesse aus den R&D-Laboren in die Fabs der Kunden.

Die Fertigung, Montage und das Packaging verschiedener Komponenten und Dies in einem einzigen Gehäuse wird gegenüber der herkömmlichen Skalierung der Transistorgröße immer wichtiger für die Leistungsfähigkeit der resultierenden Chips. Die heterogene Integration und insbesondere die Fähigkeit, ICs und Chiplelets dreidimensional übereinander stapeln zu können, sind die Voraussetzungen dafür. Denn die 3D- und die heterogene Integration ermöglichen es, Schnittstellen für die Übertragung hoher Bandbreiten zu realisieren, die die Leistung des gesamten Systems deutlich erhöhen. Das wiederum gibt KI, dem autonomen Fahren und vielen weiteren Anwendungen, die hohe Rechenleistungen erfordern, neuen Schub.

»Weil wir in unserer F&E-Fertigung über dieselben vollautomatischen und für die Fertigung in hohen Stückzahlen ausgelegten Produktionssysteme verfügen, die unsere Kunden in ihren Fabs betreiben, ermöglichen wir ihnen, die Prozesse, die am ITRI entwickelt wurden, schnell auf ihre Linien zu übertragen«, sagt Dr. Robert (Wei-Chung) Lo, Deputy General Director of Electronic and Optoelectronic System Research Laboratories am ITRI.

Hermann Waltl, Executive Sales und Customer Support Director sowie Mitglied des Executive Board der EV Group, erklärt: »Wir verfolgen die "Triple-i-Philosophie": invent-innovate-implement. Die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Forschungsinstituten wie dem ITRI bildet den Schlüssel dazu, die Entwicklung und die Kommerzialisierung neuer Technologien zu beschleunigen, um die Innovationen in der Halbleiterindustrie voranzutreiben.« Über die weitere Zusammenarbeit mit dem ITRI erhalte EVG den Zugang zu Forschungsexpertise auf Weltniveau und könne die Prozess-Infrastruktur in Taiwan weiter ausbauen. Auch das Process-and-Application-Engineering-Team von EVG, das an mehreren Standorten in Taiwan arbeitet und das Integration Competence Center am Hauptsitz von EVG in Österreich ergänzt, werde davon profitieren.

<https://www.elektroniknet.de/halbleiter/ev-group-und-itri-vertiefen-zusammenarbeit.198630.html>